

惠丰钻石股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

惠丰钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》，同意公司及子公司向合作银行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度。现将具体情况公告如下：

一、公司拟向银行申请综合授信额度的情况

为满足公司日常生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟在2024年以信用方式向合作银行申请20,000万元的综合授信额度，本授信额度可在年度内循环使用。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及贸易融资业务，在授权额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款。具体授信额度、实际借款金额、利率、期限及担保方式等以合作银行审批及签订合同为准。

在授信期限和授信额度内，公司可不再对合作银行办理的单笔借款业务单独召开董事会审议。公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件，并授权财务部门办理相关手续。

二、会议审议和表决情况

公司于2024年3月26日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。上述议案无需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

公司本次向银行申请综合授信额度是生产经营的正常需要，有利于公司提高融资效率，优化融资结构，为业务发展补充流动资金，符合公司整体利益。

四、备查文件

《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

惠丰钻石股份有限公司

董事会

2024年3月27日